

合肥晶合集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕954号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次初始公开发行股票数量为501,533,789股，发行股份占公司发行后总股本的比例为25.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至576,763,789股，约占公司发行后总股本的比例为27.71%。

本次发行后公司总股本为2,006,135,157股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为2,081,365,157股。

本次发行初始战略配售发行数量为150,460,136股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。参与战略配售

的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 125,988,825 股，约占初始发行数量的 25.12%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 24,471,311 股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 305,330,464 股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 81.30%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 67.73%。网上网下回拨机制启动前，超额配售启用前，网上初始发行数量为 70,214,500 股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 18.70%；网上网下回拨机制启动前，超额配售启用后，网上初始发行数量为 145,444,500 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 32.27%。

本次发行价格为人民币 19.86 元/股。

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 75,230,000 股，占本次初始发行股份数量的 15.00%。

发行人于 2023 年 4 月 20 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“晶合集成”股票 145,444,500 股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格 19.86 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。**同日获配多只新股的**

情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的 10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,137,537 户，有效申购股数为 168,803,053,500 股，网上发行初步中签率约为 0.08616224%。

配号总数为 337,606,107 个，号码范围为 100,000,000,000-100,337,606,106。

二、超额配售选择权实施情况

本次发行的初始发行股份数量为 501,533,789 股，其中：初始战略配售数量为 150,460,136 股，网下初始发行数量为 280,859,153 股，网上初始发行数量为 70,214,500 股（超额配售选择权启用前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 576,763,789 股。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 75,230,000 股，占初始发行股份数量的 15.00%。回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为 145,444,500 股，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的 32.27%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为 125,988,825 股，约占初始发行数量的 25.12%，与初始战略配售数量的差额 24,471,311 股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数约为 1,160.60 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 37,554,500 股）从网下回拨到网上。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 267,775,964 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 59.40%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 46.43%；网上最终发行数量为

182,999,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.60%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量 31.73%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.10840977%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于 2023 年 4 月 21 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人：	合肥晶合集成电路股份有限公司
保荐人（主承销商）：	中国国际金融股份有限公司
	2023 年 4 月 21 日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

发行人：合肥晶合集成电路股份有限公司



2023年4月21日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2023年 4月 21日